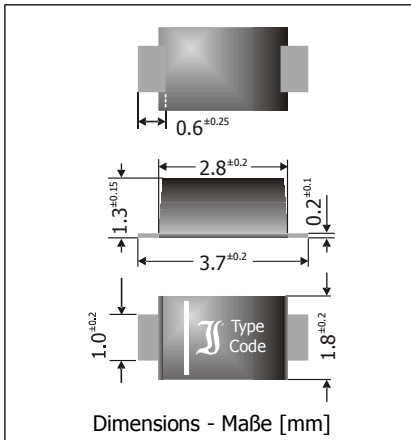



SKL32 ... SKL36

Surface Mount Schottky Rectifier Diodes Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Version 2013-05-03



Nominal current Nennstrom	3 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...60 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOD-123FL
Weight approx. – Gewicht ca.	0.02g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzen-sperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾	
			Typ.	Max.
SKL32	20	20	0.47	0.50
SKL33	30	30	0.47	0.50
SKL34	40	40	0.47	0.50
SKL35	50	50	0.67	0.70
SKL36	60	60	0.67	0.70

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	SKL32..34 ²⁾ SKL35..36 ³⁾	I_{FAV}	3 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	10 A ⁴⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	40/45 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	8 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

1 $I_F = 3$ A, $T_j = 25^\circ\text{C}$

2 $T_T = 125^\circ\text{C}$

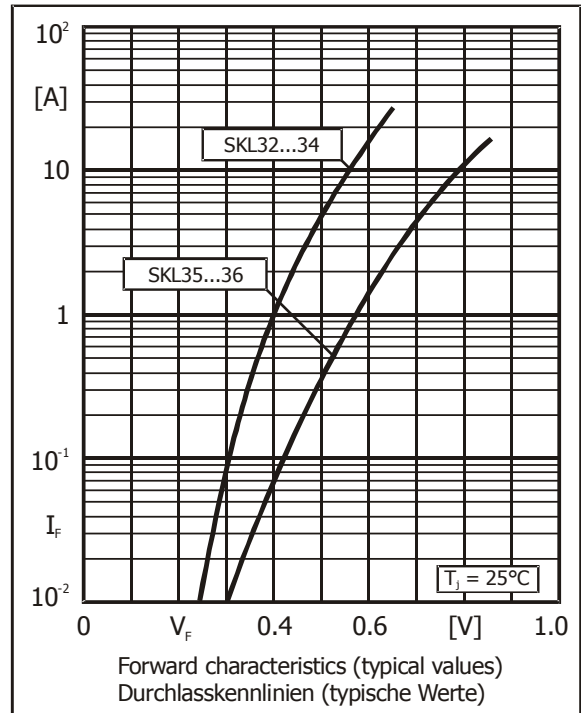
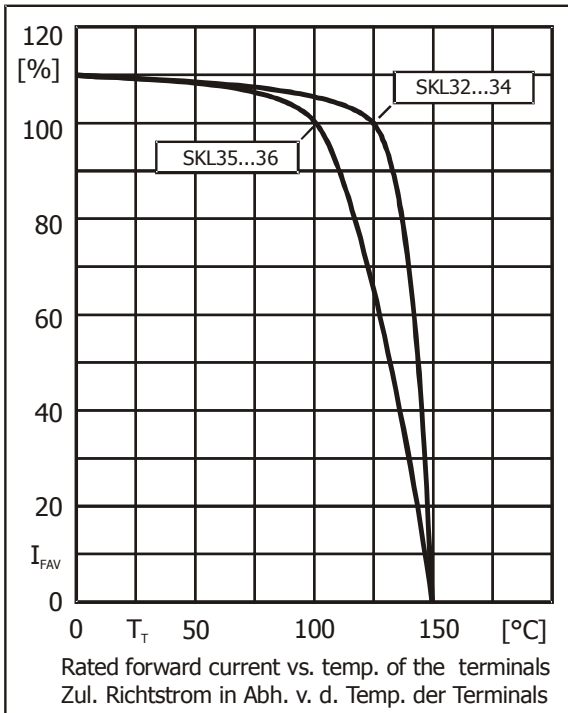
3 $T_T = 100^\circ\text{C}$

4 Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 100^\circ\text{C}$

Characteristics

Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	typ. $30\mu\text{A}$
	$T_j = 100^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	$< 200\mu\text{A}$ $< 18\text{mA}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	$< 110\text{K/W}^{-1}$)
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss		R_{thT}	$< 30\text{K/W}$



1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss